

# 유럽 반도체 법안의 주요 내용 및 전망

**이현진** 세계지역연구센터 선진경제실 유럽팀 전문연구원 (hjeanlee@kiep.go.kr, Tel: 044-414-1226)

**윤형준** 세계지역연구센터 선진경제실 유럽팀 연구원 (hjyoon@kiep.go.kr, Tel: 044-414-1064)



## 차 례

1. 유럽 반도체 시장 현황
2. 유럽 반도체 법안의 주요 내용
3. 평가 및 전망

## 주요 내용

- ▶ 미국과 중국 등 주요 반도체 생산국들이 자국 내 반도체 생산 역량 강화를 추진하고 있어, EU도 이에 대한 대응이 필요한 실정임.
  - 유럽은 전 세계 반도체 수요의 약 20%를 차지하고 있지만, 공급 능력은 그 절반 수준인 10%대에 머물러 대외 의존이 높은 편으로, 반도체 기술, 제조 장비 및 일부 원자재 수급에는 강점이 있으나 생산 역량은 주요 경쟁국에 비해 뒤처져 있다고 평가됨.
  - 코로나19로 인한 세계 반도체 공급망의 교란과 주요국의 전략물자 자국 우선주의 심화로 EU 역내 반도체 생산에 대한 요구가 크게 증가하고 있음.
- ▶ EU 집행위원회는 2022년 2월 8일 유럽 반도체 법안(Chips Act)을 '규정(Regulation)'의 형태로 발의했으며, 동 법안은 다음과 같이 크게 3개의 주요 내용을 포함하고 있음.
  - [유럽 반도체 이니셔티브(Chips for Europe Initiative)] 반도체 이니셔티브 설립을 통해 △유럽의 집적 반도체기술 설계능력 강화 △누구나 이용 가능한 파일럿라인 지원 및 개발 △양자 칩 개발을 위한 최첨단 기술 및 엔지니어링 역량 제고 △역량 센터 네트워크 형성 지원 △관련 기업의 자금조달을 위한 '반도체 기금' 운영 및 투자 유치 등의 활동을 할 예정임.
  - [공급 안정화(Security of supply) 체계 마련] 처음 시도되는 반도체 제조 역량을 갖춘 설비인 '통합생산설비'와 '개방형 EU 제조공장'에 대한 체계를 제시하여 공급망 안정화에 기여하고자 함.
  - [모니터링 및 위기 대응 조정체계 형성] EU 회원국과 EU 집행위원회 간의 긴밀한 조정체계(coordination mechanism)를 마련하여 반도체 위기 가능성을 모니터링하고 위기 발생 시 공동 대응하고자 함.
  - 동 법안을 기반으로 총 430억 유로가 반도체 사업에 투입될 것으로 기대됨.
- ▶ EU 회원국들의 반도체 부족 관련 공동대응 필요성에 대한 인식과 유럽 내 관련 산업계의 동 법안에 대한 긍정적인 반응으로 볼 때, EU의 반도체 생태계 역량 강화가 순조롭게 추진될 것으로 예상됨.
  - 다만 유럽을 포함한 주요국들이 반도체 지원을 강화함에 따라 향후 보조금 지원을 둘러싼 주요국간 무역 분쟁으로 이어질 가능성이 있음.

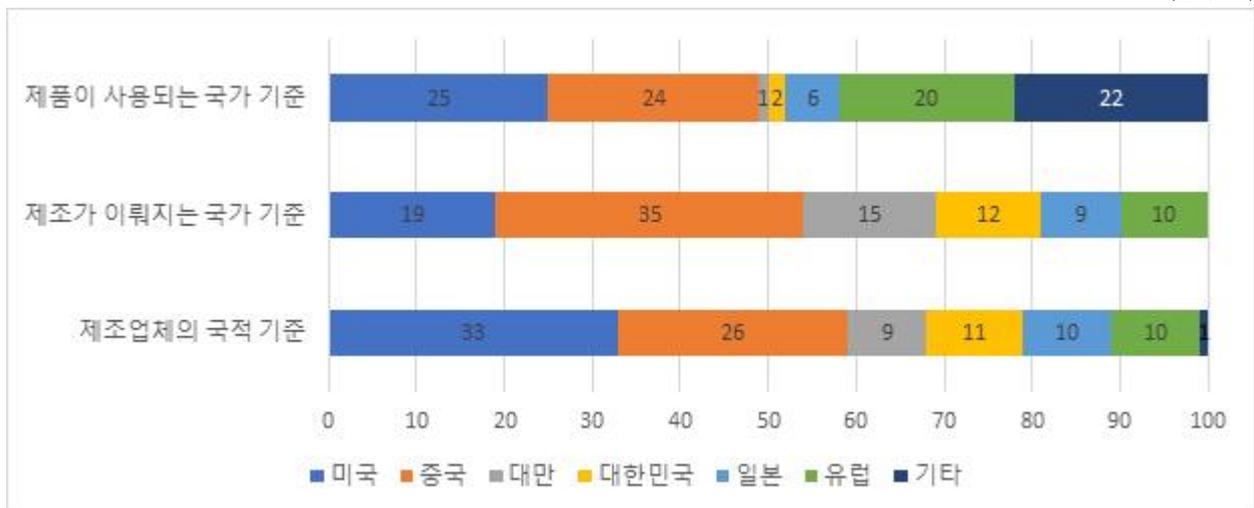
## 1. 유럽 반도체 시장 현황

■ 유럽은 전 세계 반도체 수요의 약 20%를 차지하고 있지만, 공급 능력은 그 절반 수준인 10%대에 머물러 대외 의존이 높은 편임(그림 1 참고).

- 2019년 기준 유럽은 세계 반도체 생산량의 약 20%를 소비하는 것으로 나타나 미국 및 중국에 이어 세계에서 3번째로 큰 소비 시장임.
- 그러나 반도체 생산에서 유럽의 세계 시장 점유율은 10%대에 불과하여 대외 의존이 높은 편임.
  - 유럽과 마찬가지로 반도체의 주요 수요국인 미국은 자국 제조업체의 수 및 생산 규모에서 유럽을 크게 앞지르고 있어 대외 의존의 정도가 상대적으로는 약함.

그림 1. 국가(지역)별 세계 반도체 시장 점유율(2019년 기준)

(단위: %)



자료: BCG & SIA(2021), "Strengthening the semiconductor supply in an uncertain era"(검색일: 2022. 2. 27).

■ 유럽의 반도체 산업은 반도체 기술, 제조 장비 및 일부 원자재 수급에 강점이 있는 것으로 알려져 있으나 생산 역량은 주요 경쟁국에 비해 뒤처져 있다고 평가됨.<sup>1)</sup>

- [기술] EU 기업들은 반도체 미세화 공정기술인 극자외선 리소그래피(EUV lithography) 및 완전 공핍형 실리콘 인슐레이터(FDSOI)를 개발하는 등 첨단 기술을 선도하고 있음.
  - EUV lithography 기술 및 장비는 네덜란드 ASML 홀딩스가 개발하여 전 세계 관련 장비시장의 90% 이상을 점유하고 있으며 FDSOI는 스위스에 본사를 두고 있는 STMicroelectronics가 개발하여 (이탈리아, 프랑스 등지에서 생산) 삼성 등 세계 주요 업체가 활용하고 있음.<sup>2)</sup>

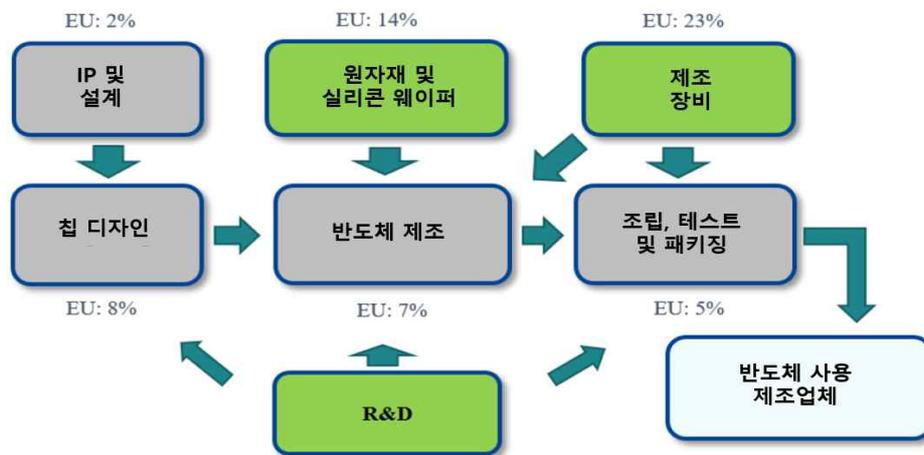
1) European Commission(COM(2022) 45), "Communication from the Commission: A Chips Act for Europe," <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation>(검색일: 2022. 2. 28).

2) 이 외에도 반도체 설계에 특화된 영국의 ARM사 등이 유럽의 반도체 기술 및 설계 분야를 선도.

- [제조 장비] 특히 앞선 기술로 EU산 반도체 제조 장비(Manufacturing equipment)는 세계 시장의 약 23%를 점유하고 있음.
- [원자재 및 실리콘 웨이퍼] EU의 반도체 기판(substrate) 및 제조에 사용되는 가스류 일부 등은 세계 시장 점유율이 14%로 나타남. 3)
- [생산 및 패키징] 유럽의 반도체 생산은 대부분 제3국에 생산을 위탁하는 팹리스(fabless) 방식으로 이뤄지고 있어 역내 제조와 조립, 테스트 및 패키징(후공정)은 세계 시장의 7% 수준으로 비중이 낮은 편임.4)

그림 2. 반도체 공급망 세부 공정별 EU 시장점유율

(단위: %)



자료: European Commission(검색일: 2022. 2. 27).

■ 코로나19로 인한 세계 반도체 공급망 교란과 전략물자에 대한 주요국의 자국 우선주의 심화로 EU 역내 반도체 생산에 대한 요구가 크게 증가하고 있음.

- 코로나19로 시작된 반도체 수급 불균형이 장기화되면서 유럽 주요 제조기업들의 생산량 회복이 더뎠고 반도체 가격이 상승하는 등 경제회복의 걸림돌로 작용하고 있음
- 특히 반도체 수요가 많은 자동차, ICT, 전자제품의 경우 생산 적체가 심하여 관련 기업 중 30~50% 정도가 부정적인 영향을 받고 있는 것으로 나타남.5)
  - 유럽자동차공업협회(ACEA)는 반도체 부족의 근본적인 해결책으로 EU 역내 생산이 강화되어야 한다고 공개적으로 EU 집행위원회에 요청함.6)
- 또한 환경 및 디지털 전환이 가속화됨에 따라 반도체 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

3) 일례로 한-일 무역분쟁 과정에서 반도체 제조에 사용되는 에칭가스 및 포토레지스트(감광액) 등이 유럽산으로 대체되기도 함.  
 4) 패키징은 반도체 제조의 후(後)공정의 일부로 칩이 제 역할을 할 수 있도록 외부와 전기적으로 연결하고, 외부 환경으로부터 보호될 수 있도록 처리하는 것을 말하며 반도체의 고용량, 초고속 및 소형화 추세에 따라 고신뢰성 확보를 위해 그 역할이 계속 중요해지고 있음. SK하이닉스 홈페이지, <https://news.skhynix.co.kr/post/next-generation-semiconductor>(검색일: 2022. 3. 4).  
 5) ECB, "The semiconductor shortage and its implication for euro area trade, production and prices," [https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202104\\_06~780de2a8fb.en.html](https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202104_06~780de2a8fb.en.html)(검색일: 2022. 2. 27).  
 6) 유럽자동차공업협회(ACEA), "Chip shortage: auto industry calls for more EU-made semiconductors," <https://www.acea.auto/message-dg/chip-shortage-auto-industry-calls-for-more-eu-made-semiconductors/>(검색일: 2022. 2. 28).

- 미국과 중국 등 주요 반도체 생산국들이 자국 내 반도체 생산 역량 강화를 추진하고 있어 EU도 이에 대한 대응이 필요한 상황임.
- 미국 바이든 행정부는 2021년 2월 반도체를 4대 핵심 품목으로 지정하고 공급망 검토 및 자국 생산 역량 강화를 위한 지원 정책을 추진 중임.<sup>7)</sup>
  - 미국 인텔사는 이에 호응하여 미국 오하이오주에 200억 달러 규모의 대규모 반도체 공장을 건설할 계획이며 향후 10년간 약 1,000억 달러를 투자한다는 계획을 발표함.
- 중국은 2021년 「14차 5개년 계획 및 2035 중장기 목표」에서 반도체 생산 역량 강화를 위한 국가전략 수립, 국가 반도체 기금 조성 및 세제지원 등을 적극 추진하고 있음.<sup>8)</sup>
  - 특히 미국의 견제를 극복하기 위해 중국이 상대적으로 취약한 설계 소프트웨어(EDA), 고순도 소재, 중요 제조장비 및 제조기술 등 3세대 반도체 개발을 적극 추진한다는 계획임.

## 2. 유럽 반도체 법안의 주요 내용

### 가. 반도체 법안 개요

- EU 집행위원회는 2022년 2월 8일 유럽 반도체 법안(Chips Act)을 ‘규정(Regulation)’의 형태로 발의함.
- EU 집행위원회는 연구, 생산 및 공급망 등 유럽의 반도체 생태계를 강화하고 반도체 가치사슬 전(全)단계에서 EU가 참여하여 2030년까지 EU산 반도체의 글로벌 시장점유율을 20%로 확대하기 위한 목적으로 동 법안을 발의함.
- 유럽 반도체 법안의 정식 명칭은 ‘유럽 반도체 생태계 강화를 위한 체계 형성을 위한 규정(proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem)’임.
  - 규정은 가장 강력한 형태의 EU 규범으로, 발효 시 회원국 법률 내 수용절차 없이 곧바로 적용됨.
- 유럽 반도체 법안은 다음과 같이 크게 3개의 주요 내용을 포함하고 있는데, EU 집행위원회는 동 법안이 가져올 효과가 시기별로 다를 것으로 기대하고 있음.
- 동 법안의 3개 주요 내용은 △EU의 대규모 반도체 기술 역량 수립 및 혁신에 기여할 ‘유럽 반도체 이니셔티브(Chips for Europe Initiative)’ 설립(법안 제3~9조) △처음 시도되는 ‘통합생산설비’와 ‘개방형 EU 제조공장’을 통해 투자유치, 반도체 생산역량 강화, 패키징, 실험, 조립 등 공급 안정화(Security of supply) 확보를 위한 체계 마련(제10~14조) △EU 집행위원회와 회원국 간의 ‘모니터링 및 위기 대응(Monitoring and crisis response)’을 위한 조정체계 형성(제15~22조)임.

7) 윤여준 외(2021), 「바이든 행정부의 4대 핵심 품목 공급망 검토 결과 및 시사점」, KIEP 세계경제 포커스, 21-41호(검색일: 2022. 2. 28).

8) 연원호(2021), 「미·중 갈등과 중국의 반도체 산업 육성전략 및 전망」, KIEP 세계경제 포커스, 21-39호(검색일: 2022. 2. 28).

- EU 집행위원회는 동 법안이 △단기적으로 반도체 위기 예측 및 EU 집행위원회와 회원국 간의 긴밀한 조정체계 확립에 기여하고 △중기적으로 EU의 반도체 생산 활동을 강화하고 반도체 전체 가치사슬 단계에서의 생산 규모 확대 및 혁신을 통해 역내 공급 안정성을 확보하면서 회복력 있는 반도체 생태계 형성에 기여하며 △장기적으로 유럽의 기술 리더십을 강화하는 동시에 연구기반 제조(the lab to the fab) 관련 지식 이전 지원 및 기술 선도를 위한 기술 역량을 마련할 수 있을 것으로 전망함.

■ 동 법안을 기반으로 정부(EU 포함)예산 활용 및 민·관 합작투자(PPP)가 활성화 되면 총 430억 유로가 반도체 사업에 투입될 것으로 기대됨.

- 430억 유로의 투자 규모(약 57조 원)는 미국 정부가 추진 중인 반도체진흥법안(Chips for America Act)의 투자규모인 520억(약 63조 원) 달러에 조금 못 미치는 수준

## 나. ‘유럽 반도체 이니셔티브(Chips for Europe Initiative)’ 설립

■ 동 법안에 따라 설립 예정인 ‘유럽 반도체 이니셔티브’는 △유럽의 집적반도체기술 설계능력 강화 △누구나 이용 가능한 파일럿라인 지원 및 개발 △양자 칩 개발을 위한 최첨단 기술 및 엔지니어링 역량 제고 △역량 센터 네트워크 형성 지원 △관련 기업의 자금조달을 위한 ‘반도체 기금’ 운영 및 투자 유치 등의 활동을 할 예정임.

- 최첨단 고밀도 집적반도체기술 설계 능력을 강화: △기존 및 신규 반도체 설계 설비와 자료실 및 전자설계 자동화(EDA) 장치를 통합하여 EU 역내 혁신적인 가상 플랫폼(virtual platform)을 개발 △진행 중인 혁신 개발품의 설계 능력 강화 △수직적인 반도체 시장을 통합하여 반도체 생태계를 확대하고 EU의 녹색·디지털·혁신 어젠다에 기여
- 기존 파일럿라인(pilot line) 강화 및 새로운 최첨단 파일럿라인 개발): △연구혁신 활동을 통합하고 미래 기술노드(technology node) 개발을 준비하여 차세대 칩 생산 기술력의 강화 △실험, 검사 및 주요 기능을 통합하는 새로운 설계 개념의 유효성 확인을 위해 신규 및 기존 파일럿라인을 이용할 수 있도록 지원 △‘통합생산설비(Integrated Production Facilities)’ 및 ‘개방형 EU 제조공장(Open EU Foundries)’에 신규 파일럿라인에 대한 우선 이용 혜택 제공
- 양자 칩(quantum chip)의 혁신적인 개발을 가속화하기 위한 최첨단 기술 및 엔지니어링 능력 형성
- EU 내 역량센터(competence centre) 네트워크 형성: △반도체 관련 중소기업이나 스타트업 등의 역량 강화 및 폭넓은 전문성 제공 △기술 향상 지원, 신규 인력 유치 및 반도체 분야에서의 숙련 노동력 확대를 위한 지원

9) ‘파일럿라인(pilot line)’은 ‘반도체 생산 전 성능 테스트를 위해 설비를 돌려보는 과정’임. 「삼성, 450mm 웨이퍼 시대 연다, 인텔-TSMC와 ‘파일럿 라인’ 맞손」(2015. 5. 8), 『뉴데일리경제』, <https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2015/05/08/2015050810001.html>(검색일: 2022. 3. 3).

- 스타트업, 스케일업, 중소기업 등 반도체 관련 기업의 자금조달을 위한 ‘반도체 기금(Chips Fund)’ 운영 및 투자 유치: △EU 재원 활용과 민간 부분에서의 자금 유치를 통해 승수효과 달성 △자금조달이 어려운 기업에 대한 지원 △반도체 제조 기술과 칩 설계에 대한 공공 및 민간 부분에서의 투자 가속화 및 반도체 가치사슬 전체에 대한 공급 안정화 확대

■ 유럽 반도체 이니셔티브의 직접 소요되는 EU 예산 규모는 총 33억 유로로 Horizon Europe과 디지털 유럽 프로그램(Digital Europe Programme)으로부터 각각 16억 5천 유로씩 총당할 예정임.

- 전체 예산 중 28억 7,500만 유로는 반도체공동사업(Chips Joint Undertaking, 기존 Key Digital Technologies Undertaking에서 명칭 변경), 1억 2,500만 유로는 InvestEU, 3억 유로는 유럽혁신위원회(EIC: European Innovation Council)로부터 조달 예정임.

■ 유럽 반도체 이니셔티브의 주 운영은 ‘반도체공동사업(Chips Joint Undertaking)’에서 실시할 예정임.

- 유럽 반도체 이니셔티브의 실행에 대해 ‘반도체공동사업’이 EU 집행위원회가 정한 측정가능한 지표로 모니터링하고 이행결과에 대해 보고하도록 정하고 있음.
- 이니셔티브의 활동은 기존의 △디지털 유럽 프로그램 △Horizon Europe △ERDF, ESF+, 지역개발을 위한 유럽농업기금(European Agricultural Fund for rural Development), 유럽 해양·어업·양식 기금(European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund) △유럽 연결 장치(Connecting Europe Facility) △InvestEU 프로그램 △Erasmus+ 등 EU 프로그램들과 시너지 효과를 내도록 운영할 예정임.

## 다. 공급 안정화(Security of supply) 체계 마련

■ 역내 공급망 안정 및 회복력 있는 반도체 생태계 형성에 기여할 수 있는 반도체 제조 역량을 갖춘 설비인 ‘통합생산설비’와 ‘개방형 EU 제조공장’에 대한 체계를 제시함.

- ‘통합생산설비(IPF: Integrated Production Facilities)’와 ‘개방형 EU 제조공장(OEF: Open EU Foundries)’은 처음 시도되는(first-of-a-kind) 설비, 차세대 반도체를 위한 투자 등 EU 반도체 가치사슬에서의 긍정적인 효과가 분명히 나타나도록 관련 기준을 정함.
  - 통합생산설비: 전공정(front-end)이나 후공정(back-end) 혹은 이들 모두를 포함한 반도체 설계 및 제조 설비로, 생산 설비를 수직적으로 통합
  - 개방형 EU 제조공장: 전공정이나 후공정 혹은 이들 모두를 포함한 제조설비로, 팹리스(fabless) 반도체 기업(반도체 설계만 하고 생산은 하지 않는 기업)과 같은 다른 산업 관계자들에 상당한 정도의 생산역량을 제공
- 동 법안이 정한 기준을 충족시켰을 경우에만 EU 회원국들로부터 보조금을 수혜할 수 있으며, 보조금에 대한 심사는 신속절차(fast track)로 진행될 수 있음.

## 라. 모니터링 및 위기 대응 조정체계 형성

■ [모니터링] EU 반도체 가치사슬에서의 정기적인 모니터링 및 조기 경고 시스템을 도입할 예정으로, 모니터링 활동 및 산업계의 참여 유도를 위한 EU 회원국들의 역할이 강조됨.

- 산업계의 참여 유도를 위해서 각 회원국들이 반도체 수요공급과 관련된 이해관계자들의 정보를 수집하고 정기적으로 정보 업데이트를 하며 유럽반도체이사회(European Semiconductor Board)에서 정보교환을 하도록 함.
- 각 EU 회원국들이 잠재적인 반도체 위기를 발견하거나 모니터링 혹은 이해관계자들로부터 획득한 정보를 통해 위험요소를 발견할 경우 EU 집행위원회에 통보함.
- EU 집행위원회는 회원국들로부터 수집한 정보를 바탕으로 유럽반도체이사회 특별회의를 소집하고 공급망 문제 해결을 위해 적절한 조치를 취할 계획임.

■ [위기 대응] EU 반도체 공급망 내 실질적인 부족 위기가 발생할 경우, EU 집행위원회는 위기대응령을 가동하고 기업이나 기관들에 관련 정보를 요구할 수 있음.

- ‘반도체 위기’는 심각한 공급 차질로 인해 △개별 EU 회원국의 주요 경제부문에서 상당한 지연 혹은 부정적 영향이 나타났을 경우 △민감 분야에서 사용되는 핵심 제품에 대한 공급·수리·보수가 이루어지지 못할 경우를 말함.
- EU 집행위원회는 반도체 위기의 발생 시 기관이나 기업들로부터 받은 생산 가능성, 생산량, 현재 상태 등 데이터를 통해 반도체 위기를 파악하고 EU 및 개별국 차원의 잠재적 완화 혹은 대응 조치 평가를 위해 관련 주요 정보를 수집하며 위기 툴박스(emergency toolbox) 조치를 취할 수 있음.
  - 위기 툴박스 조치에는 △통합생산설비(IPF)나 개방형 EU 제조공장(OEF)에 위기의 영향을 받는 제품들에 대한 우선구매 주문(priority rated order)을 넣고 이행을 요구 △2개국 이상 EU 회원국의 요청에 따라 이들을 대항한 공동구매(common purchasing) 추진 등이 있음.
  - 반도체 위기 대응 응급조치가 적용되는 기간은 EU 집행위원회가 유럽반도체이사회회의의 자문을 통해 연장할 수 있음.

## 3. 평가 및 전망

■ 유럽 반도체 법안은 EU 회원국들의 지지를 받고 있어 입법이 순조롭게 진행될 것으로 전망됨.

- EU 회원국들은 2020년 12월에 ‘프로세서 및 반도체 기술에 관한 공동성명’에 서명하여 유럽의 반도체 설계 및 생산 설비 제고 및 공동대응의 필요성에 대해 인지한 바 있음.<sup>10)</sup>

10) 사이프러스, 덴마크, 리투아니아, 룩셈부르크, 스웨덴을 제외한 22개 회원국이 서명에 참여함. European Commission, “Joint declaration on processors and semiconductor technologies,” <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/joint-declaration-processors-and-semiconductor-technologies>(검색일: 2022. 3. 2).

- EU 집행위원회는 2021년 7월 ‘프로세서 및 반도체 산업연맹(Industrial Alliance on Processors and Semiconductors)’을 창설하여 동 법안이 제시하는 ‘유럽 반도체 이니셔티브’의 형성을 용이하도록 함.<sup>11)</sup>
  - 이와 유사한 사례로 EU 집행위원회는 2017년 유럽배터리연맹(European Battery Alliance)을 발족 후 2018년 ‘배터리에 대한 전략적 활동계획(Strategic Action Plan on Batteries)’을 발표했으며, 유럽의 첫 배터리 공장(Northvolt)이 2018년에 기공, 2019년에 성공적인 시험생산을 마쳤고 2021년부터 본격 가동을 시작함.

■ 유럽 내 반도체 제조사, 협회 등 및 관련 산업계에서는 동 법안에 대해 반기는 분위기를 보이고 있음.

- 네덜란드 기반 반도체 제조기업인 ASML社は 동 법안이 추구하는 유럽 내 반도체 R&D 및 생산 확대에 대한 지지의사를 밝힘.<sup>12)</sup>
- CECIMO(유럽 기계장치산업 및 관련 제조기술협회)는 동 법안에 명시된 역외 공급망 의존도를 낮추고 반도체 개발에 있어서 전략적 자주성을 강화한다는 목적에 지지성명을 발표함.<sup>13)</sup>
- SEMI(글로벌 전자기기제조 및 설계 공급망 산업협회)는 유럽 반도체 법안에 갈채를 보내며, 글로벌 반도체 산업을 강화하고 강력한 공급망을 형성할 동 법령 및 유사 법령과 인센티브를 지지한다고 언급함.<sup>14)</sup>
- 다만 동 법안에서 제시한 예산 규모가 매우 큰 규모인바, 기존 예산의 용도 변경 외에도 각 회원국들의 보조금 지급기준을 상당히 완화하여 재원을 마련해야 할 것으로 보고 있으며, R&D 투자가 이익실현으로 이어질지에 대한 우려도 제기됨.<sup>15)</sup>

■ 한편 유럽을 포함한 주요국들의 반도체 지원이 강화함에 따라 향후 보조금 지원을 둘러싸고 주요국간 무역 분쟁이 발생할 가능성이 있음.

- 반도체 산업에 대한 정부보조금은 다른 국가에서 문제를 제기할 경우 WTO 「보조금 및 상계조치에 관한 협정」(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures: SCM) 적용을 위한 조사 대상이 될 수도 있음.
  - WTO SCM의 규정 중 ‘조치가능보조금’(일명 ‘황색 보조금’)은 특정 산업에 지급된 보조금이 다른 회원국에 부정적인 효과를 유발하였을 경우 상계관세를 부과할 수 있도록 규정되어 있으나, 보조금의 성격 및 부정적 효과의 판정에 법적 다툼의 여지가 많아 불확실성이 높음. KIEP

11) European Commission, “Digital sovereignty: Commission proposes Chips Act to confront semiconductor shortages and strengthen Europe’s technological leadership,” [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_22\\_729](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_729)(검색일: 2022. 2. 23).

12) ASML, “European Chips Act - ASML position paper,” <https://www.asml.com/en/news/press-releases/2022/asml-position-paper-on-eu-chips-act>(검색일: 2022. 3. 1).

13) CECIMO, “CECIMO’s reaction to the European Chips Act proposal,” <https://www.cecimo.eu/news/cecimos-reaction-to-the-european-chips-act-proposal/>(검색일: 2022. 3. 1).

14) SEMI, “SEMI applauds the release of the European Chips Act,” <https://www.semi.org/eu/news-media-press-releases/semi-press-releases/semi-applauds-release-of-european-chips-act>(검색일: 2022. 3. 1).

15) “Europe Aims to Boost Microchip Output With Cash and Relaxed Aid Rules”(2022. 2. 8), *The Wall Street Journal*, <https://www.wsj.com/articles/europe-aims-to-boost-microchip-output-with-billions-in-new-funding-11644322236>(검색일: 2022. 3. 1).